

cicor



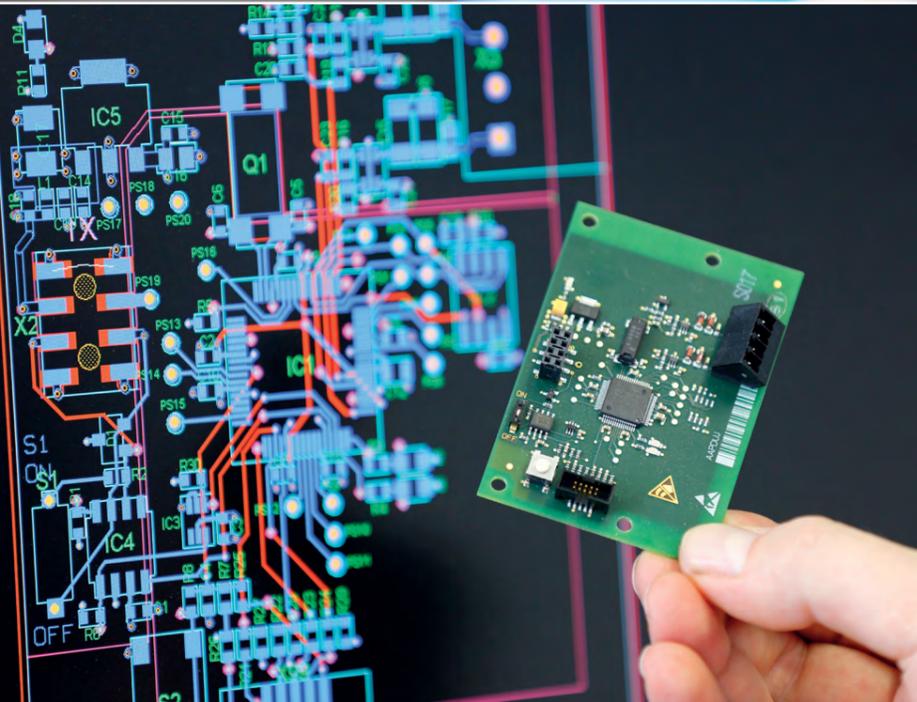
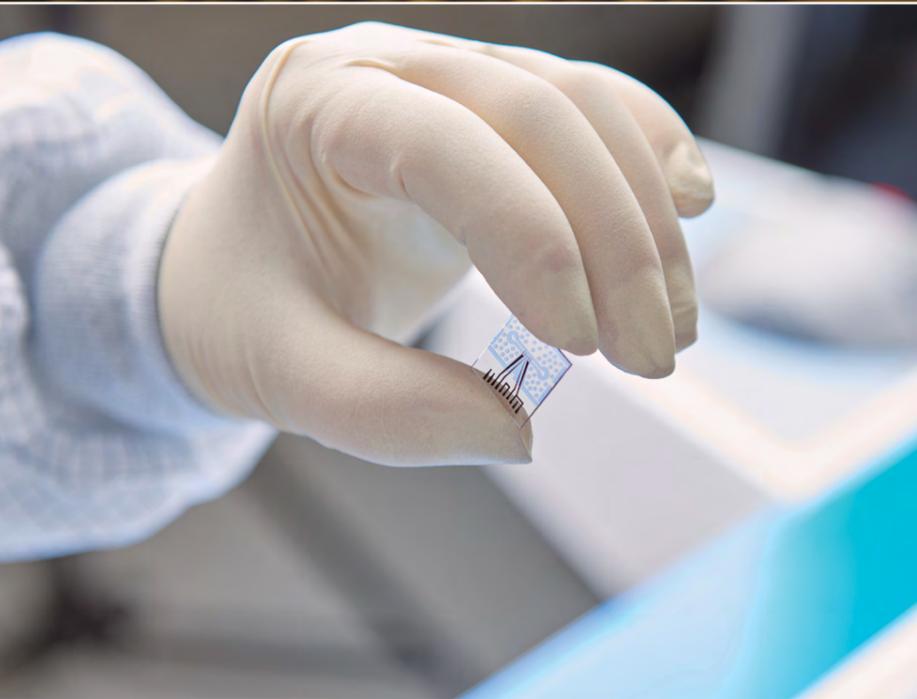
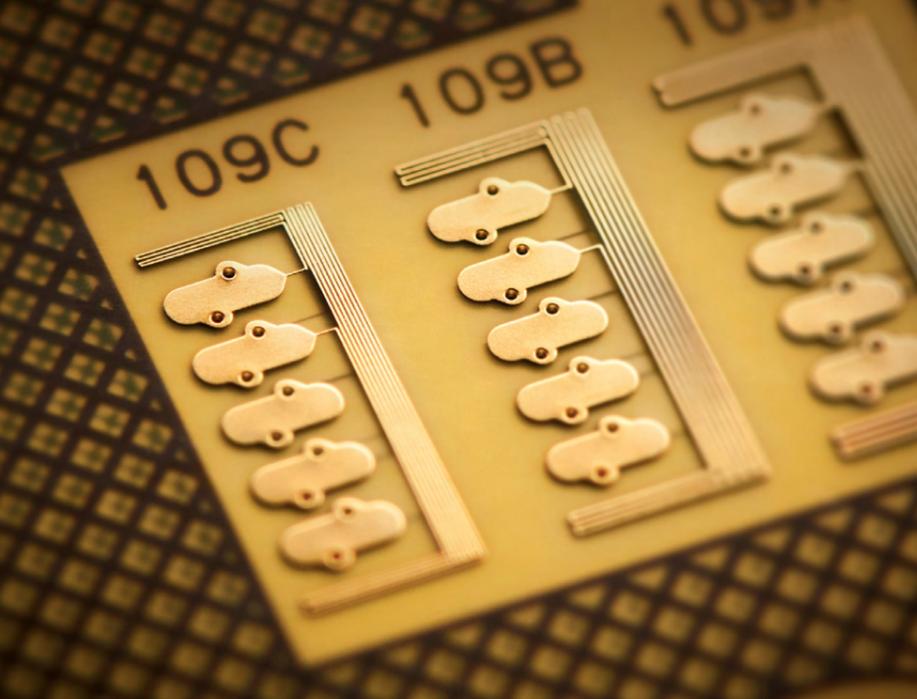
Ihr Technologiepartner

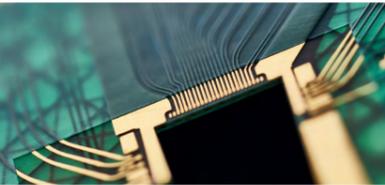
Vom Design bis zum fertigen Produkt

Innovative Technologielösungen rund um Ihre Elektronik

Die heutige Cicor Gruppe ging aus der 1966 in Lausanne (Schweiz) gegründeten Cicorel SA hervor und ist ein global tätiger Lösungsanbieter mit einem weltweit einzigartigen Dienstleistungs- und Technologieportfolio. Mit rund 2200 Mitarbeitenden an zwölf Produktionsstandorten bietet die Cicor Gruppe hochkomplexe Leiterplatten und Hybridschaltungen sowie umfassende Electronic Manufacturing Services (EMS) inklusive Mikroelektronikbestückung und Kunststoff-Spritzguss. Cicor liefert massgeschneiderte Produkte und Dienstleistungen vom Design bis zum fertigen Produkt aus einer Hand.

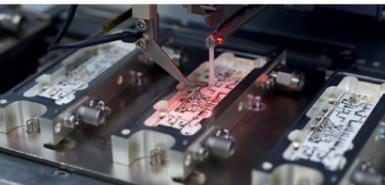
Neuste Erkenntnisse verknüpft mit langjähriger Erfahrung und der Einsatz modernster Technologien verbunden mit hoher Fachkompetenz machen Cicor zu einem zuverlässigen und innovativen Partner bei der Entwicklung und Herstellung von überzeugenden Lösungen rund um die Elektronik.





Leiterplatten (PCBs)

Der Cicor-Standort in Boudry (Schweiz) ist ein Leiterplattenhersteller, der auf anspruchsvolle Anwendungen und höchst miniaturisierte Schaltungen spezialisiert ist. Der Standort entwickelt und produziert hochwertige starre, starr-flexible und flexible Leiterplatten mit Schwerpunkt High- und Ultra-High-Density Interconnects.



Substrate und Hybridschaltungen

Mit den Standorten Radeberg (Deutschland), Ulm (Deutschland) und Wangs (Schweiz) ist Cicor ein führender Hersteller hochwertiger Dünn- und Dickschichtsubstrate sowie Hybridschaltungen. Die Dickschichttechnologie ist eine ausgereifte Technologie zur Herstellung von Verdrahtungsträger. Die Dünnschichttechnologie kommt dort zum Einsatz, wo höchste Anforderungen an Miniaturisierung, Hochfrequenzleistungen und Biokompatibilität gestellt werden.



Gedruckte Elektronik

Der Cicor-Standort in Bronschhofen (Schweiz) bietet gedruckte Elektronik mit einer einzigartigen Drucktechnologie, die das Drucken verschiedenster leitfähiger, nicht leitfähiger und biokompatibler Materialien auf vielfältigsten Trägermaterialien und -formen ermöglicht. Zusätzlich bieten sich neue Möglichkeiten von Verbindungstechnologien, die zu Performance-Verbesserungen und Kostenoptimierungen führen können.

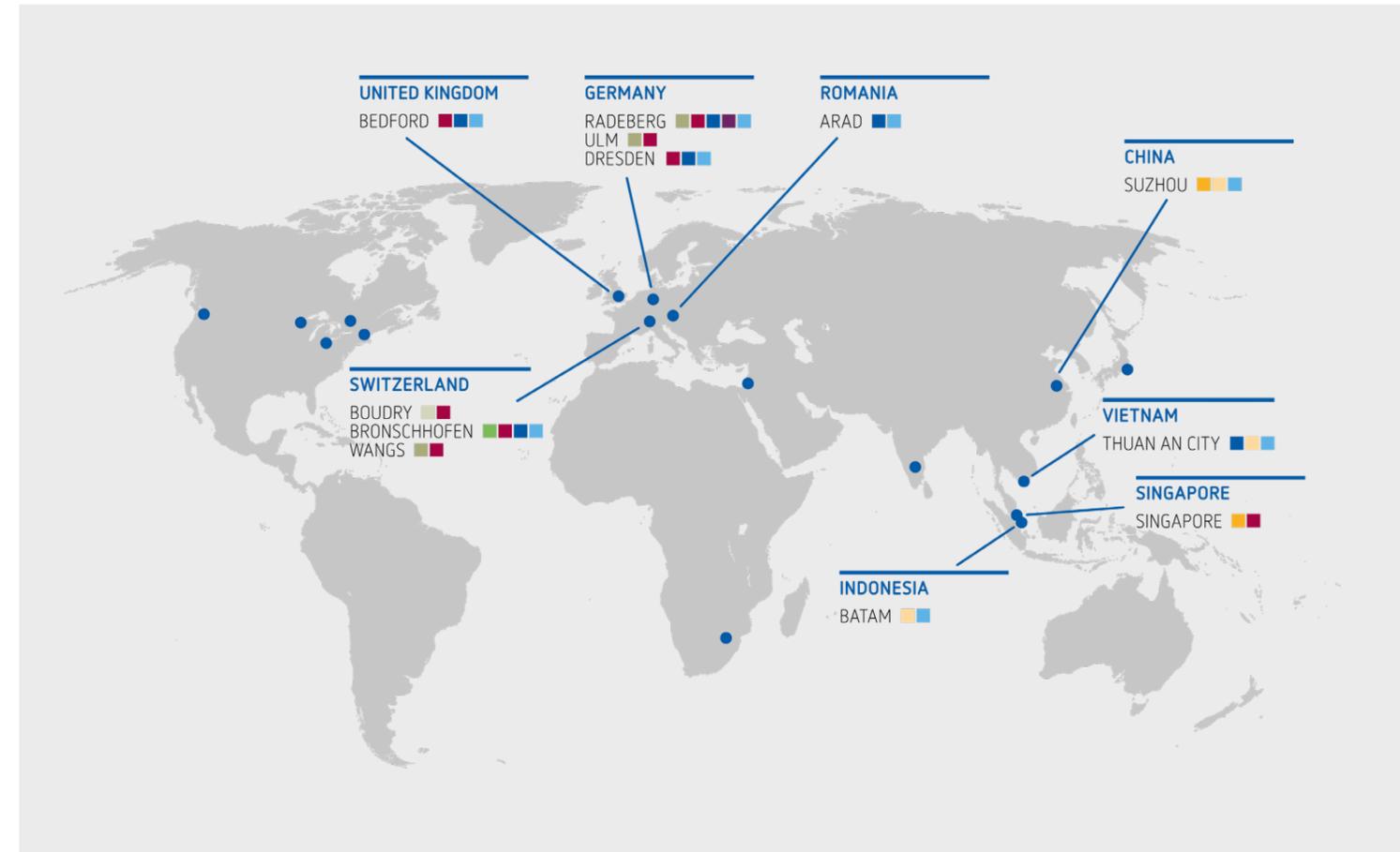


Electronic Manufacturing Services (EMS)

Die Produktionsstandorte in Bronschhofen (Schweiz), Arad (Rumänien), Radeberg und Dresden (Deutschland), Bedford (Grossbritannien), Singapur (Singapur), Suzhou (China), Batam (Indonesien) und Thuan An City (Vietnam) sind Dienstleister im Bereich Hardware- und Software-Entwicklung sowie Fertigung von elektronischen Baugruppen, Geräten und Systemen. Mit einem breiten Fertigungsspektrum in den Bereichen Leiterplattenbestückung, Mikroelektronikbestückung, Geräte- und Systembau, Schaltschrankbau, Kabelkonfektion, Werkzeugdesign und -herstellung sowie Kunststoffspritzguss bietet Cicor kundenspezifische Lösungen von der Idee bis zum fertigen Produkt.

Cicor Verkauf und Vertretungen

Die globale Aufstellung und die Kundennähe von Cicor erweisen sich als Schlüssel zum Erfolg. Durch diverse Verkaufsbüros- und Vertretungen in den Fokusländern gewährleistet Cicor eine gleichbleibend hohe Servicequalität während des gesamten Produktlebenszyklus.



- Leiterplatten (PCBs)
- Substrate und Hybridschaltungen
- Gedruckte Elektronik
- Entwicklung
- Electronic Manufacturing Services (EMS)
 - Leiterplattenbestückung
 - Mikroelektronikbestückung
 - Werkzeugdesign und -herstellung
 - Kunststoff-Spritzguss
 - Geräte- und Systembau
- Cicor Verkauf und Vertretungen

Cicor liefert massgeschneiderte Produkte und Dienstleistungen vom Design bis zum fertigen Produkt aus einer Hand.



Medizin

In der Medizintechnik eröffnet der technologische Fortschritt stetig neue, faszinierende Möglichkeiten für die Entwicklung und Herstellung elektronischer Geräte. Gerade im medizinischen Bereich führt der Einsatz neuer Technologien zu überzeugenden Lösungen für intelligente Implantate, Beatmungsgeräte, biokompatible Sensoren und kleinste Hörgeräte. Neue Technologien ermöglichen zunehmend komplexe Geräte mit immer mehr Funktionen auf immer kleinerem Raum.



Luft-/Raumfahrt und Verteidigung

In der Luft-/Raumfahrt und Verteidigung realisiert die Elektronikindustrie Lösungen für die Stromversorgung, Navigation, Steuerung und für Kabinenzubehör, von leichten und komplexen Produkten, bis hin zu nahezu unzerstörbaren Lösungen. Basierend auf höchsten Test- und Produktionsstandards, beweist Cicor kontinuierlich die Präzision der Fertigungsprozesse und gewährleistet die Rückverfolgbarkeit der Produkte innerhalb der verschiedenen Stufen der Lieferkette.



Automobil und Transport

In der Automobil- und Transporttechnik helfen aktive Sicherheitssysteme Unfälle zu vermeiden. Fahrer-müdigkeitserkennung, Spurassistentensysteme, Einparkhilfen, intelligente Scheinwerfersteuerung oder vorausschauender Fussgängerschutz sind längst Realität. Der technologische Fortschritt eröffnet stetig neue, faszinierende Möglichkeiten für die Entwicklung und Herstellung solcher elektronischer Systeme.



Industrie

In der Industrietechnik bietet die Elektronik zahlreiche Anwendungen für die Gebäudesicherheit, für Zugangskontrollsysteme, die Gebäudesteuerung oder im sanitären Bereich. Im Energiesektor sorgen elektronische Steuer- und Regelsysteme für eine optimale Energieversorgung bei maximaler Sicherheit. Sensoren werden in der Überwachungs- und Sicherungstechnik, in der Prozesssteuerung, in der Industrie-Automation und in wissenschaftlichen Einrichtungen eingesetzt.



Kommunikation

In der Kommunikationstechnik werden Design- und Lifestyle-Aspekte berücksichtigt. Im Alltag helfen uns rechnergestützte Verkehrsleitsysteme, die den ständig wachsenden Verkehr lenken. In Fahrzeugen dienen intelligente Sensoren und smartes Wohnen wird durch die Vernetzung von Haushaltsgeräten, der Haustechnik oder Multimediageräten möglich und erhöht den Komfort und die Sicherheit.



Uhren und Konsumgüter

In der Uhren- und Konsumgüterindustrie haben sich viele Geräte im Laufe der Zeit zu modernen Helfern im Alltag entwickelt. Tragbare Elektronik wie Smartwatches, Datenbrillen, Kopfhörer oder smarte Kleidung – Wearable Devices sind heute Wirklichkeit und gehören zum Alltag. Wichtige Anreize für Neuentwicklungen sind die Fortschritte in der Miniaturisierung.



Hörgeräte

Die Cicor Gruppe ist als global tätiger Outsourcing-Partner für die Produktion zahlreicher Elektronik- und Kunststoffkomponenten für die Hörgeräteindustrie verantwortlich. Als langjähriger Partner bietet Cicor Entwicklungsdienstleistungen, hochstehende Leiterplatten, Elektronikbestückung, Werkzeugbau sowie Kunststoff-Spritzguss, Geräte- und Systembau aus einer Hand.



Satellitenkommunikation

Die Substrate Produktionsstandorte der Cicor Gruppe erfüllen die hohen Qualitäts- und Zuverlässigkeitsanforderungen des Raumfahrtmarkts. Cicor beweist kontinuierlich die Präzision ihrer Fertigungsprozesse und gewährleistet die Rückverfolgbarkeit der Produkte innerhalb der verschiedenen Stufen der Lieferkette.



Augeninnendrucksensor

Die Cicor Gruppe entwickelt und produziert für einen Kunden eine flexible Antennenspule (flexibles Dünnschichtsubstrat auf Polyimidbasis) für einen implantierbaren Augeninnendrucksensor.



Beatmungsgeräte

Die Cicor Gruppe erfüllt die hohen Anforderungen an die Entwicklung und Produktion elektronischer, medizinischer Geräte und Systeme. Cicor entwickelt als EMS-Partner eine funktional sichere Steuerung für Jet Ventilation Beatmungsgeräte. Maximale Zuverlässigkeit, Systemstabilität und funktionale Sicherheit sind Voraussetzung.



Passagierinformationssysteme

Cicor übernimmt als Elektronikfertiger die Produktion der Baugruppen und elektronischer Geräte für Betriebsleitsysteme, die weltweit im Einsatz sind. Als EMS-Partner übernimmt Cicor den kompletten Geräte- und Systembau, spezifische Tests und After-Sales-Services.



Regelsysteme

Als EMS-Partner entwickelt und produziert Cicor Regelsysteme für Temperiergeräte. Cicor entwickelte die modulare Steuerung, die den Einsatz in allen Gerätetypen erlaubt. Die Lösung ist als hochgradig verteiltes System konzipiert – ein Zusammenschluss unabhängiger Controller, die sich dem Benutzer als System präsentieren.

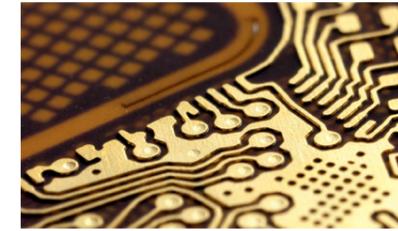
Leiterplatten (PCBs)

Cicor entwickelt und produziert seit über 50 Jahren anspruchsvolle flexible, starr-flexible und starre Leiterplatten von der Idee, über Prototypen bis hin zur Grossserienproduktion. Dank der umfassenden Fachkompetenz im Bereich der Multilayer-Boards (MLBs), Multi-Chip-Module (MCMs), und High-Density-Interconnects (HDIs) entwickelt Cicor innovative und zuverlässige Lösungen für anspruchsvolle Anwendungen in der Medizin, Luft-/Raumfahrt und Verteidigung, Automobil und Transport sowie den Kommunikations-, Industrie- und Uhren-/Konsumgütermärkten.

Dünne Materialien sowie Leiter- und Abstandsbreiten bis 25 µm ermöglichen eine weitere Miniaturisierung und fortschrittliche Ultra-HDI-Lösungen. Die neu eingeführte DenciTec® Technologie eröffnet dafür vollkommen neue Möglichkeiten. Durch die Kombination von PCB-Verfahren und der Dünnschichttechnologie lassen sich innovative Schaltungen herstellen.

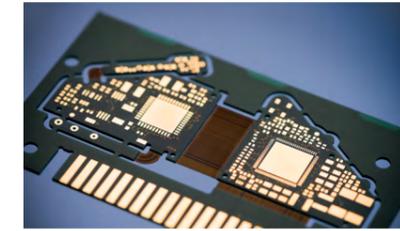
Gedruckte Elektronik

Die von Cicor eingesetzte, einzigartige Drucktechnologie ermöglicht das Drucken verschiedenster leitfähiger, nicht leitfähiger und biokompatibler Materialien auf vielfältigsten Trägermaterialien und -formen. Zusätzlich bieten sich neue Möglichkeiten von Verbindungstechnologien, die zu Performance-Verbesserungen und Kostenoptimierungen führen können.



Flexible Leiterplatten

Flexible Leiterplatten (FPC) bieten ein Höchstmass an 3D-Miniaturisierung. Dank der äusserst geringen Biegeradien in Kombination mit Ultra-HDI (Ultra High Density Interconnect) können immer kleinere, hochintegrierte Geräte gefertigt werden. Cicor ist seit vielen Jahren Marktführer auf diesem Gebiet und fertigt Flex-Schaltungen mit 1–8 Lagen.



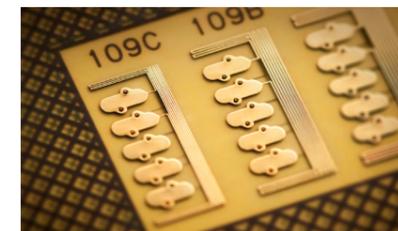
Starre-flexible Leiterplatten

Die Kombination der Vorzüge von starren und flexiblen Leiterplatten in einer Leiterplatte bietet verschiedene Vorteile, wie unter anderem die Reduzierung der Bauteilgrösse und Möglichkeit einer dreidimensionalen Montage bestückter Leiterplatten. Der Einsatz dieser Technologie verbessert die Signalintegrität und Zuverlässigkeit, insbesondere in Umgebungen, in denen Vibrationen, Beschleunigungen und andere schwere Bedingungen auftreten.



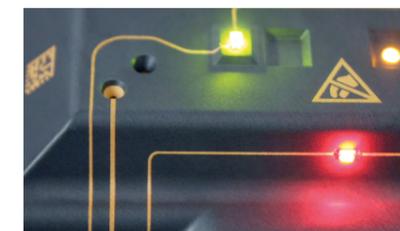
Starre Leiterplatten

Starre Leiterplatten sind in vielen verschiedenen Varianten erhältlich. Sie unterscheiden sich durch die Anzahl der Lagen, die verwendeten Basismaterialien, die Konstruktionsverfahren, die Verbindungsarten sowie die Einsatzbereiche. Cicor bietet starre Leiterplatten mit 1–20 Lagen mit klarem Fokus auf die Miniaturisierung in der x-, y- und z-Achse.



DenciTec®

Mit DenciTec® wird weitere Miniaturisierung möglich. Zu diesen Möglichkeiten gehören Leiter- und Abstandsbreiten bis zu 25 µm bei Kupferdicken von 20 ± 5 µm auf allen leitenden Lagen, Laser-Via-Durchmesser von 30 µm, Restringe mit einem Durchmesser von 30 µm auf den Innenlagen und 20 µm bei den Aussenlagen, kupfergefüllte Blind-Vias mit der Möglichkeit zum Via-Stacking und Vias in Pads.



3D-MID

Die 3D-MID-Technologie (3 Dimensional Molded Interconnect Devices) ermöglicht es, in einem Bauteil auf engstem Raum mechanische und elektronische Funktionen zu integrieren. Die elektronische Schaltung wird dabei in das Gehäuse integriert; dies erhöht die kompakte Bauweise und die Funktionsdichte entscheidend. Spritzgegossene Schaltungsträger erlauben es, die Prozessschritte, die Montagezeiten und die Anzahl Bauteile zu reduzieren.



Gedruckte Elektronik

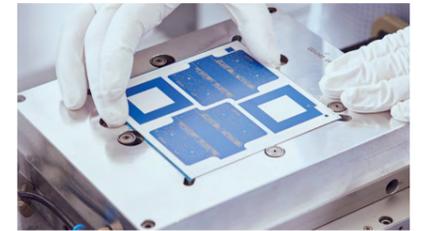
Durch die Integration der Schaltkreise in dreidimensionale Oberflächen entfällt vielfach die Notwendigkeit der Verwendung eines zusätzlichen Substrates. Dieser effiziente Druckprozess erlaubt Linien und Abstände bis zu 10 µm und eine Druckdichte von < 100 nm bis zu Zehntel µm.



Substrate und Hybridschaltungen

Dünnschichtsubstrate finden dort ihren Einsatz, wo die herkömmlichen Leiterplattentechnologien keine adäquate technische Lösung bieten können. Möglich sind starre und flexible Mehrlagenschaltungen mit höchster Auflösung (10 µm). Die Dünnschichttechnologie verwendet Verfahren der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik um Schaltungsträger auf keramischen oder organischen Werkstoffen herzustellen. Verbindungsträger (Substrate) in Dünnschichttechnik erlauben hierbei extreme Verbindungsdichten, hochgenaue Geometrien von Leitern und Isolatormaterialien, hohe Wärmeleitfähigkeit und bieten höchste Zuverlässigkeit.

Die Dünnschichttechnik punktet hier mit der Verwendbarkeit von beispielsweise Keramik oder Quarzglas als Substratmaterial, und der hohen erreichbaren Strukturtreue mit Toleranzen bis zu $\pm 2 \mu\text{m}$ für die Leiterbahnweite. Die Leitungszüge in der Dickschichttechnik werden im Siebdruckverfahren aufgebracht und anschliessend eingebrannt. Der Einsatz von Keramik als Substrat ermöglicht höchste Zuverlässigkeit unter härtesten Umgebungsbedingungen. Eine Dickschichtschaltung ist der Standard-Leiterplatte in Hinblick auf Temperaturbeständigkeit und Lebensdauer deutlich überlegen.



Starre Dünnschichtsubstrate

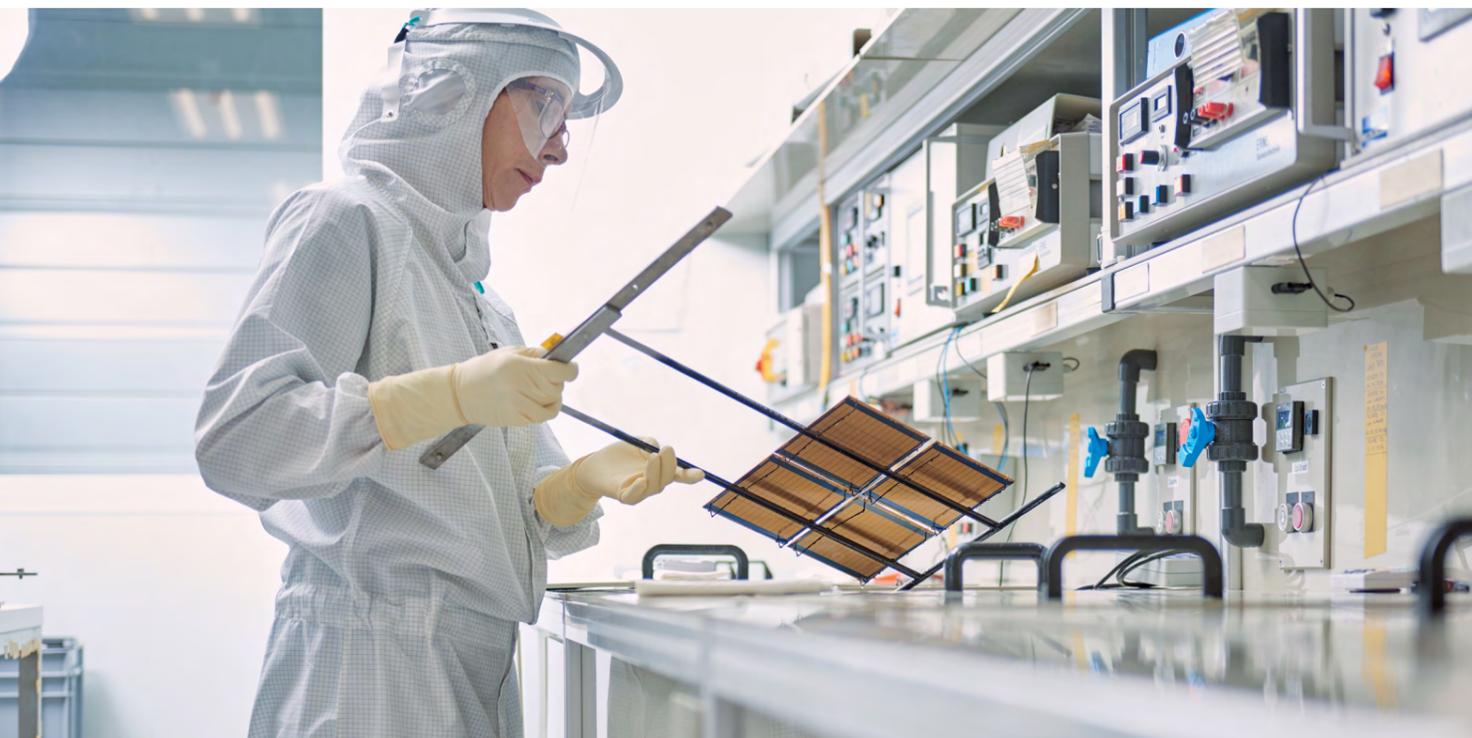
Dünnschichtsubstrate auf der Basis von starren Substratmaterialien werden bereits jahrzehntelang für Anwendungen z.B. in der Raumfahrt, Radartechnik oder Sensorik gefertigt und angewendet. Neben dem Standardmaterial Al_2O_3 , das es in verschiedenen Güteklassen gibt, wird auch zunehmend Aluminiumnitrid eingesetzt, vor allem bei Anwendungen die eine erhöhte Wärmeleitfähigkeit erfordern. Daneben werden ebenfalls Schaltungen auf z.B. Ferritmaterial oder auch Glas hergestellt, die jeweils auf die unterschiedlichsten Anwendungen angepasst werden können.

Flexible Dünnschichtsubstrate

Im Bereich der flexiblen Dünnschichtsubstrate werden dieselben Technologien und Verfahren zur Herstellung von Schaltungen verwendet wie bei starren Substraten. Hier liegt allerdings der Schwerpunkt auf der Verwendung von organischen Materialien die entweder aus der flüssigen Phase als Isolator (bzw. Substrat) verarbeitet werden oder bereits als Folienmaterial vorhanden sein können. Vorwiegend kommt in diesem Bereich Polyimid, in verschiedenen Ausprägungen, oder LCP (Liquid Crystalline Polymer) als Substratmaterial zur Anwendung. Der Bereich der Materialdicke erstreckt sich bei den flexiblen Substraten von wenigen Mikrometern bis hin zu mehreren 100 µm bei z.B. Mehrlagenschaltungen auf LCP-Basis.

Dickschichtsubstrate

Die Dickschichttechnik ist eine seit Jahrzehnten praktizierte und sehr ausgereifte Technologie zur Herstellung von Verdrahtungsträgern. Die Leitungszüge werden im Siebdruckverfahren aufgebracht und anschliessend eingebrannt. Der Einsatz von Keramik als Substrat ermöglicht höchste Zuverlässigkeit unter härtesten Umgebungsbedingungen. Die Hauptvorteile dieser Technologie liegen in der Verwendung von Keramik als Verdrahtungsträger mit exzellenten Wärmeleitungseigenschaften, der Realisierung von gedruckten Widerständen über ein grosses Spektrum (mOhm bis GOhm) mit der Möglichkeit jeden Wert mit Hilfe des Laserabgleichs herstellen zu können. Auch die Möglichkeit des Aktivabgleichs von Dickschichtwiderständen nach der Bauelementebestückung sind vorteilhaft.



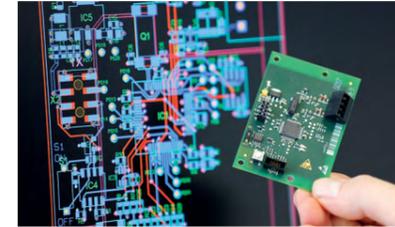


Electronic Manufacturing Services (EMS)

Die Cicor Gruppe ist ein international aufgestellter Elektronikdienstleister mit einem breiten Fertigungsspektrum in der Leiterplattenbestückung, in Geräte- und Systembau, im Schaltschrankbau, in der Kabelkonfektion und im Bereich von Werkzeugdesign und -herstellung sowie Kunststoffspritzguss.

Als global tätige Gruppe mit EMS-Produktionsstandorten in der Schweiz, Deutschland, Rumänien, Grossbritannien und Asien (Singapur, Vietnam, Indonesien, China) nutzt die Gruppe Synergien und bietet Lösungen, die auf langjährigem Know-how basieren.

Cicor bietet Outsourcing-Lösungen für die Entwicklung und Herstellung elektronischer Baugruppen sowie kompletter Geräte und Systeme.



Entwicklungsdienstleistungen

Cicor entwickelt innovative Elektronik und zugehörige Software für Kunden und unterstützt dabei von der Idee bis zum fertigen Produkt. Target-Costing, Design-for-Manufacturing, Design-for-Testability und Design-for-Traceability werden in der täglichen Arbeit praktisch umgesetzt. Produktspezifische Prüfsysteme vom In-Circuit-Test bis zum komplexen Funktionstestsystem werden intern entwickelt und hergestellt.



Leiterplattenbestückung

Cicor produziert kundenspezifische Elektronikbaugruppen effizient und in höchster Qualität. Dabei wird das ganze Spektrum von Kleinst- bis Grossserien abgedeckt. Dank dem globalen Produktions-Set-up mit Standorten in Bronschhofen (Schweiz), Arad (Rumänien), Bedford (Grossbritannien) und in Thuan An City (Vietnam) verfügt Cicor über kosteneffiziente Strukturen, welche genau auf die Bedürfnisse des Kunden abgestimmt werden können.



Mikroelektronikbestückung

Die Cicor Gruppe bietet ein umfangreiches Portfolio an Aufbau- und Verbindungstechnik zur Herstellung mikroelektronischer Module und Baugruppen an. Mehrere Produktionslinien stehen für vollautomatische und halbautomatisierte Prozesse zur Verfügung. Die Schwerpunkte der Bestückungstechnologien sind SMD-Montage, Chipmontage, Drahtbonden, Verschluss, Screening und das Testing.



Werkzeugdesign und -herstellung

Cicor ist auf die Herstellung von Präzisions-Spritzguss-Werkzeugen aus Stahl spezialisiert, welche den höchsten Qualitätsansprüchen genügen und über die gesamte Produktlebensdauer eine fehlerfreie Produktion mit hoher Kapazität gewährleisten. Techniker verwandeln mit Hilfe modernster Software auch komplexe Produktentwürfe in Präzisionskunststoffteile. Die ausgereiften Formentwürfe erfüllen die anspruchsvollsten Anforderungen der Kunden.



Kunststoffspritzguss

Die Cicor Gruppe entwirft und fertigt qualitativ hochwertige und präzise Kunststoff-Spritzgussformen und bietet Kunststoff-Spritzguss mit vertikal integrierten Sekundärprozessen sowie die Montage von kompletten Produkten. Das Portfolio umfasst 2K-Spritzguss, Insert Molding, Dünnwand-Spritzguss/Präzisionsspritzguss sowie Mikrospritzguss von Kunststoffteilen mit 2 mm Durchmesser und Mikroaufbau.



Geräte- und Systembau

Die Cicor Gruppe bietet Dienstleistungen bis zur Montage von komplexen Geräten und Systemen. Cicor unterstützt bereits bei der Idee und Entwicklung von fertigungsgerechten Produkten die eine möglichst kostengünstige Fertigung sicherstellen. Mit der lückenlosen Rückverfolgbarkeit durch das verifizierte Qualitätsmanagementsystem, wird die Auslieferqualität auf höchstem Niveau sichergestellt.



Arad, Rumänien

Der Cicor Standort in Arad (S.C. Systronics S.R.L.) bietet Fertigungsdienstleistungen für elektronische Produkte von hoher Qualität. Der Standort unterstützt seine Kunden bereits in der Planungsphase und garantiert so die optimale Outsourcing-Lösung, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten ist. Als EMS-Partner über den gesamten Produktlebenszyklus, von der Produktentwicklung über die Serienproduktion bis hin zum After-Sales-Service. Der EMS-Standort in Rumänien bietet komplette Outsourcing-Lösungen für die Fertigung von elektronischen Baugruppen sowie komplette Geräte und Systeme.

13'500 m² Gesamtfläche



Batam, Indonesien

Der Cicor Standort Batam (PT Cicor Panatec) ist ein Hersteller von hochwertigen Kunststoff-Spritzgussteilen mit Reinraum-Montageleistungen für Medizinprodukte. Der Standort liegt strategisch günstig in Batam, nur eine Stunde vom Cicor Standort in Singapur entfernt. In Kombination mit Singapur bietet der Standort Engineering, Kunststoff-Spritzguss, vertikal integrierte Sekundärprozesse und Montagedienstleistungen. Der Produktionsstandort verfügt über modernste Produktionsanlagen und insgesamt 1'200 m² Reinräume (ISO Klasse 7) für Spritzguss, Montage und Verpackung. Die Reinräume sind für medizinische RTU-Anwendungen (Ready-to-use) validiert.

10'000 m² Gesamtfläche



Bedford, Grossbritannien

Ursprünglich als Teil eines führenden internationalen Elektronikunternehmens gegründet, wurde der Cicor Standort in Bedford (Axis Electronics Ltd.) 1995 als unabhängiger, in Grossbritannien ansässiger Anbieter von elektronischen Fertigungsdienstleistungen mit einer einzigartigen Kombination aus Service und technologischen Fähigkeiten gegründet.

Das Unternehmen hat sich im Laufe der Jahre erheblich weiterentwickelt und genießt heute das Vertrauen von vielen marktführenden europäischen Unternehmen, insbesondere aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, als deren bevorzugter Fertigungspartner.

3'250 m² Gesamtfläche



Boudry, Schweiz

Der Cicor Standort in Boudry (Cicorel SA, gegründet 1966) ist ein Hersteller von High-End-Leiterplatten, der sich auf die Miniaturisierung von Schaltungen und anspruchsvolle Anwendungen spezialisiert hat. Der Standort entwickelt und produziert hochwertige starre, starr-flexible und flexible Leiterplatten (PCB) und verfügt über umfassendes Know-how in den Bereichen Multilayer-Boards (MLB) sowie High-Density- und Ultra-High-Density Interconnects (HDI und uHDI). Der Standort in Boudry arbeitet eng mit seinen Kunden aus der Medizin-, Luft-/Raumfahrt und Verteidigung, Automobil sowie den Kommunikations-, Industrie- und Uhren-/Konsumgüterindustrie zusammen.

5'000 m² Gesamtfläche



Bronschhofen, Schweiz

Der Cicor Standort in Bronschhofen (Swisstronics Contract Manufacturing AG) bietet komplette Outsourcing-Lösungen für die Entwicklung und die Herstellung elektronischer Baugruppen sowie kompletter Geräte und Systeme. Cicor entwickelt und produziert am Standort in Bronschhofen mit modernstem Equipment kleinere und mittlere Serien elektronischer Baugruppen und Systeme. Der Standort verfügt über ausgeprägtes Know-how in der Medizintechnik. Im neu erstellten, geschützten Montagebereich der ISO Klasse 8 werden Medizinprodukte mit erhöhten Anforderungen an die Montageumgebung hergestellt.

7'500 m² Gesamtfläche



Dresden, Deutschland

Der Cicor Standort in Dresden (Cicor Deutschland GmbH) bietet ganzheitliche Dienstleistungen für die Entwicklung und die Fertigung elektronischer Baugruppen, überwiegend in den Märkten Medizintechnik und Industrie. Als Systemlieferant bietet der Standort den Kunden die Möglichkeit, den Fertigungsprozess ganz nach Wunsch zu erweitern. Mit den Full-Service-Paketen begleitet Cicor ihre Kunden bis zum Versand der verkaufsfertigen Endprodukte.

4'000 m² Gesamtfläche

Electronic Manufacturing Services (EMS)

- Leiterplattenbestückung
- Test Entwicklung
- Geräte- und Systembau

Electronic Manufacturing Services (EMS)

- Kunststoff-Spritzguss
- Geräte- und Systembau

Electronic Manufacturing Services (EMS)

- Entwicklung
- Leiterplattenbestückung
- Geräte- und Systembau
- Test Entwicklung

Leiterplatten

- Entwicklung
- Starre PCB
- Flexible PCB
- Starr-flexible PCB
- DenciTec®

Electronic Manufacturing Services (EMS)

- Entwicklung
- Leiterplattenbestückung
- Geräte- und Systembau
- Test Entwicklung

Gedruckte Elektronik

Electronic Manufacturing Services (EMS)

- Entwicklung
- Leiterplattenbestückung
- Geräte- und Systembau
- Test Entwicklung

- ISO 9001
- ISO 14001
- OHSAS 18001/ISO 45001
- IATF 16949

- ISO 9001
- ISO 13485
- ISO 14001
- ISO 14644
- ISO 17025
- OHSAS 18001/ISO 45001
- IATF 16949
- Zertifikat GMP
- FDA registriert
- UL-Zulassung

- ISO 9001
- AS 9100

- ISO 9001
- ISO 14001
- OHSAS 18001/ISO 45001

- ISO 9001
- ISO 13485
- ISO 14001
- ISO 15378
- MFi Partner
- FDA registriert
- UL-Zulassung

- ISO 9001
- ISO 14001
- IATF 16949



Radeberg, Deutschland

Der Cicor Standort in Radeberg (RHe Microsystems GmbH) ist spezialisiert auf die Herstellung komplexer Substrate in Dickschichttechnik sowie die Mikroelektronikbestückung auf Keramik oder Leiterplatten. Die Kernbranchen sind Luft-/Raumfahrt und Verteidigung, Medizin sowie anspruchsvolle Anwendungen im Industriebereich. Zum Leistungsbereich des Standortes gehören die Entwicklungsunterstützung, der Prototypenbau, die Serienfertigung sowie branchenspezifische Produktqualifikationen. Die Prüfplätze für Funktionstests in der Serienfertigung werden intern entwickelt und aufgebaut.

3'600 m² Gesamtfläche

Substrate und Hybridschaltungen

- Entwicklung
- Dickschichtsubstrate
- Hybridschaltungen

Electronic Manufacturing Services (EMS)

- Entwicklung
- Mikroelektronikbestückung

- ISO 9001
- ISO 13485
- KTA 1401
- EN 9100



Singapur, Singapur

Der Cicor Standort in Singapur (Cicor Asia Pte Ltd) entwickelt hochwertige Präzisions-Kunststoff-Spritzgussformen. Cicor Singapur verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Herstellung von technisch komplexen Formen und Kunststoffteilen mit überlegener technischer und ingenieurtechnischer Kompetenz. Cicor Asia Pte Ltd, ist zudem die die Vertriebsniederlassung von Cicor in Asien, die für das Produkt- und Projektmanagement, einschliesslich Neuprodukte-Einführung, zuständig ist.

1'800 m² Gesamtfläche

Electronic Manufacturing Services (EMS)

- Werkzeugdesign und -herstellung

- ISO 9001
- ISO 14001
- IATF 16949



Suzhou, China

Der Cicor Standort in Suzhou (Suzhou Cicor Technology Co. Ltd.) bietet Werkzeugdesign und -herstellung sowie Kunststoff-Spritzguss an. Suzhou liegt im SND-EPZ Sub-Industrial Park, 18 km von Suzhou City und 100 km vom Hafen von Shanghai entfernt. Ausgestattet mit modernster Ausrüstung, Werkzeugbau und Maschinenpark zur Herstellung kundenspezifischer Produkte. Der Produktionsstandort verfügt über ein umfangreiches Know-how in der Herstellung von 3D-MID (Molded Interconnect Devices).

9'200 m² Gesamtfläche

Electronic Manufacturing Services (EMS)

- Werkzeugdesign und -herstellung
- Kunststoff-Spritzguss
- 3D-MID

- ISO 9001
- ISO 13485
- IATF 16949
- UL-Zulassung



Thuan An City, Vietnam

Der Cicor Standort in Thuan An City (Cicor Anam Ltd.) bietet Leiterplattenbestückung, Geräte- und Systembau inklusive Kunststoff-Spritzguss-Dienstleistungen an. Der Standort ist nur 20 km von Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon) entfernt. Er befindet sich im Vietnam Singapore Industrial Park und verfügt über modernste Maschinen für die Leiterplattenbestückung (PCBA). Der Produktionsstandort bedient Kunden aus den Bereichen Medizin, Industrie, Automobil und Konsumgüter. Der Standort erfüllt die RoHS-Richtlinie.

5'000 m² Gesamtfläche

Electronic Manufacturing Services (EMS)

- Leiterplattenbestückung
- Kunststoff-Spritzguss
- Geräte- und Systembau

- ISO 9001
- ISO 13485
- ISO 14001



Ulm, Deutschland

Der Cicor Standort in Ulm (Reinhardt Microtech GmbH) ist spezialisiert auf die Herstellung starrer und flexibler Substrate in Dünnschichttechnik und verfügt auf diesem Gebiet über umfassende Entwicklungskompetenzen. Die Fertigung findet im Reinraum unter Einsatz mikroelektronischer Fertigungsprozesse wie Lithographie, Sputtern, Ätzen, Galvanik und mechanische Bearbeitung statt. Die Produktion und Prozesse sind auf maximale Flexibilität ausgelegt, um auch besondere Anforderungen an Substratmaterialien und Prozesskombinationen erfüllen zu können. Der Standort bietet Dünnschichtsubstrate (Al₂O₃, AlN, LCP, Polyimid, Ferrite, Glas) in Prototypen- und Volumenfertigung.

1'656 m² Gesamtfläche

Substrate und Hybridschaltungen

- Entwicklung
- Starre Dünnschichtsubstrate
- Flexible Dünnschichtsubstrate

- ISO 9001



Wangs, Schweiz

Der Cicor Standort in Wangs (Reinhardt Microtech GmbH) ist spezialisiert auf die Herstellung starrer und flexibler Substrate in Dünnschichttechnik und verfügt auf diesem Gebiet über umfassende Fertigungskompetenzen. Die Fertigung findet im Reinraum unter Einsatz mikroelektronischer Fertigungsprozesse wie Lithographie, Sputtern, Evaporation, Ätzen, Galvanik und passiver Abgleich von Widerständen statt. Weitere Bearbeitungen sind das Laserbohren von Löchern, minimal 60 µm, das Lasern von Konturen und das Sägen als Vereinzelungsschritt vom Mehrfachnutzen zum Chip. Die Produktion und Prozesse sind auf maximale Flexibilität ausgelegt, um auch besondere Anforderungen nach Substratmaterialien und Prozesskombinationen erfüllen zu können.

2'500 m² Gesamtfläche

Substrate und Hybridschaltungen

- Entwicklung
- Starre Dünnschichtsubstrate
- Flexible Dünnschichtsubstrate

- ISO 9001
- EN 9100



Durch die konsequente Ausrichtung auf die Ansprüche der Kunden und unter Einhaltung international anerkannter Normen und Standards garantiert die Cicor Gruppe Ihren Kunden Produkte mit maximaler Zuverlässigkeit und höchster Präzision.

Das Qualitätsdaten-Management System der Cicor Gruppe geht weit über die gesetzlichen Anforderungen hinaus und verfügt über umfangreiche Funktionen. Diese werden, den spezifischen Kundenanforderungen entsprechend, konfiguriert. So kann eine lückenlose Transparenz in sämtlichen Fertigungs- und After-Sales-Prozessen an allen Standorten garantiert werden.

Alle Cicor Standorte werden in regelmässigen Abständen auditiert, die Prozesse laufend geprüft und analysiert.

Für eine aktuelle Übersicht aller Zertifikate besuchen Sie bitte www.cicor.com.

ISO 9001
Qualitätsmanagementsystem

ISO 13485
Qualitätsmanagementsystem für Medizinprodukte

ISO 14001
Umweltmanagementsystem

ISO 14644
Reinraum Klasse 7

ISO 15378
Primär-Verpackungsmaterial für Arzneimittel

ISO 17025
Qualitätsmanagementsystem für Prüf- und Kalibrierlaboratorien

EN 9100
Qualitätsmanagementsystem für die Luftfahrt

AS 9100
Qualitätsmanagementsystem für die Luft- und Raumfahrt

KTA 1401
Qualitätssicherung für Kernkraftwerke

OHSAS 18001/ISO 45001
Managementsystem für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

AQAP 2110
NATO-Qualitätssicherungsanforderungen für Entwicklung, Konstruktion und Produktion

FDA
Registrierter Contract Manufacturer Norm 21CFR820

MFi
Partner des Programms Made for iPhone, iPod und iPad

IATF 16949
Qualitätsmanagementsystem für die Automobilindustrie



Leiterplatten

Cicorel SA
Route de l'Europe 8
2017 Boudry
Schweiz
Tel. +41 32 843 05 00
info-pcb@cicor.com

Gedruckte Elektronik

Cicor Group
c/o Cicor Management AG
Gebenloostrasse 15
9552 Bronschhofen
Schweiz
Tel. +41 71 913 73 00
info@cicor.com

Substrate und Hybridschaltungen

RHe Microsystems GmbH
Heidestrasse 70
01454 Radeberg
Deutschland
Tel. +49 3528 4199-0
info-me@cicor.com

Reinhardt Microtech GmbH
Sedanstrasse 14
89077 Ulm
Deutschland
Tel. +49 731 79035 213
info-thinfilm@cicor.com

Reinhardt Microtech AG
Aeulistrasse 10
7323 Wangs
Schweiz
Tel. +41 81 720 04 56
info-thinfilm@cicor.com

Electronic Manufacturing Services

Swisstronics
Contract Manufacturing AG
Gebenloostrasse 15
9552 Bronschhofen
Schweiz
Tel. +41 71 913 73 73
info-europe@cicor.com

S.C. Systronics S.R.L.
Str III – Zona Industriale
Arad Vest, Nr. 14
310580 Arad
Rumänien
Tel. +40 257 285 944
info-europe@cicor.com

RHe Microsystems GmbH
Heidestrasse 70
01454 Radeberg
Deutschland
Tel. +49 3528 4199-0
info-me@cicor.com

Cicor Deutschland GmbH
An d. Prießnitzau 22
01328 Dresden
Deutschland
Tel. +49 351 266 130
info-europe@cicor.com

Axis Electronics Ltd.
Bedford Heights
Manton Lane
MK41 7NY Bedford
Grossbritannien
Tel. +44 1234 342932
info-europe@cicor.com

Cicor Asia Pte Ltd.
7 North Coast Avenue,
#03-66/67/68/69,
Singapore 737664
Singapur
Tel. +65 6546 16 60
info-asia@cicor.com

PT Cicor Panatec
Batamindo Industrial Park,
Lot 322-324
Jalan Beringin, Muka Kuning
Batam 29433
Indonesien
Tel. +62 770 61 22 33
info-asia@cicor.com

Cicor Anam Ltd.
15 Street 4, Vietnam
Singapore Industrial Park
Thuan An City
Binh Duong Province
Vietnam
Tel. +84 274 375 66 23
info-asia@cicor.com

Suzhou Cicor Technology Co. Ltd.
EPZ No. 11 Building
No. 666 Jianlin Road
SND-EPZ Sub-industrial Park
Suzhou, 215151
China
Tel. +86 512 6667 2013
info-asia@cicor.com



cicor

Cicor Management AG

Gebenloostrasse 15
9552 Bronschhofen
Schweiz
Tel. +41 71 913 73 00
info@cicor.com


cicor.com